ラメラ状ミクロ相分離構造を形成する SBS トリブロック 共重合体にポリブタジエンをブレンドして作成した試料の力学特性

(京工繊大院)〇福根遼哉、(高エネ研)高木秀彰、 清水伸隆、五十嵐教之、(京工繊大)櫻井伸一

1. 緒言

近年、無機材料分野において硬軟2成分からなる層状結晶構造にリプロケーションを導入することで材料が強化される現象が発見された^[1]。この原理を高分子材料にも応用できるか明らかにすることを目的として、我々は、硬軟2成分からなるラメラ状ミクロ相分離構造を形成するブロック共重合体に注目

して研究を行なっている。ここで、ミクロ相分離構造とは、互いに非相溶な高分子成分から構成さる構造である。これまでの先行研究では、スチレン・ブタジエン・スチレントリブロック共重合体(SBS)単体にキンクを導入する研究が行われたが、本研究ではSBS試料によりブタジエンホモポリマー(HPB)を少量ブレンドすることによって、Fig.1に示したような、リプロケーションの導入ができないかどうかを検討し、さらに、得られたフィルムに対して引張試験を行ない、材料が強靭化されるかどうかを明らかにした。

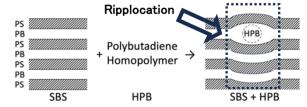


Fig. 1 Schematic illustration of ripplocation which can be obtained by blending SBS triblock copolymer with polybutadiene homopolymer.

2. 実験

用いた SBS 試料の S/B 体積比は 56/48 である。また、分子量については $M_n=6.31\times10^4$ 、 $M_w/M_n=1.15$ (M_n と M_w は各々数平均、重量平均分子量)である。HPB においては $M_n=3.25\times10^4$ 、 $M_w/M_n=1.04$ である。合計のポリマー濃度が 5 wt%になるように SBS と HPB をトルエンに溶解させた。その後、溶液をシャーレに流し込み、室温で溶媒を蒸発させてフィルム試料を作製した。また、比較として SBS 単体試料も用意した。得られたフィルムを幅 2 mm に切り取り、室温にて、初期チャック間距離 20 mm、引張速度 20 mm / min で引張試験を行った。

3. 結果と考察

4. 結論

本研究によって、HPB添加量 4wt%から5wt%でリプロケーションが導入されている可能性が示唆された。今後の詳細な構造解析によってリプロケーションの存在を明らかにする予定である。

(a) (b) Young's Modulus / MPa 400 Stress at Break / MPa 350 35 300 30 250 25 200 20 150 100 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HPB content / wt% HPB content / wt% (c) (d) 200 Arbitrary Physical 180 似的ルルスタフネス Properties 160 140 Foughness / 120 100 80 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HPB content / wt% HPB content / wt%

Fig. 2 (a) Plot of Young's modulus vs HPB content (b) Plot of tensile strength vs. HPB content (c) Plot of toughness vs. HPB content (d) Overlapped plots of approximated curves for three physical properties shown in parts (a) – (c).

引用文献 [1] Kushima et.al, Nano Lett. 2015,15,1302-1308

Mechanical properties of specimens prepared by blending polybutadiene homopolymer with SBS triblock copolymer that forms a lamellar microdomain structure. Ryouse Fukune¹, Hideaki Takagi², Nobutaka Shimizu², Noriyuki Igarashi² and Shinichi Sakurai¹, * ¹Department of Biobased Materials Science, Kyoto Institute of Technology, Kyoto 606-8585, Japan, ²High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan * Corresponding Author: shin@kit.ac.jp